

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 7 部門第 2 区分
【発行日】 令和 6 年 12 月 12 日 (2024.12.12)

【国際公開番号】 WO2023/189611
【出願番号】 特願 2024-511762 (P2024-511762)
【国際特許分類】
H05K 1/14 (2006.01)
【FI】
H05K 1/14 A
H05K 1/14 J

10

【手続補正書】
【提出日】 令和 6 年 9 月 18 日 (2024.9.18)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】 特許請求の範囲
【補正対象項目名】 全文
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項 1】

20

面方向に並ぶ複数の第 1 電極を有する第 1 基材と、
前記面方向に並ぶ複数の第 2 電極を有し、前記第 1 電極および前記第 2 電極が対向するように、前記第 1 基材に対して、前記面方向に直交する厚み方向において間隔を隔てて配置される第 2 基材と、
前記第 1 基材および前記第 2 基材の間に介在し、前記厚み方向において対向する前記第 1 電極および前記第 2 電極を、電氣的に接続するとともに、前記第 1 基材および前記第 2 基材を接着する接着層とを備え、
前記接着層の厚みが、15 μm 未満であり、
前記面方向において、隣り合う前記第 1 電極の間の距離が、前記厚み方向において対向する前記第 1 電極と前記第 2 電極との間の距離よりも長い、接続構造体。

30

【請求項 2】
前記接着層は、異方性導電性接着フィルムの硬化物であり、
前記接着層は、前記厚み方向において対向する前記第 1 電極および前記第 2 電極を電氣的に接続する柱状半田部および硬化樹脂を含む、請求項 1 に記載の接続構造体。
【請求項 3】
複数の前記第 1 電極および複数の前記第 2 電極が、それぞれ、ドットパターンとして配置されている、請求項 1 または 2 に記載の接続構造体。

【請求項 4】
前記異方性導電性接着フィルムは、半田粒子を含み、
前記半田粒子の最大長さの平均値が、3 μm 以下である、請求項 2 に記載の接続構造体。

40

【請求項 5】
前記異方性導電性接着フィルムは、半田粒子を含み、
前記半田粒子の最大長さの平均値が、2 μm 以下である、請求項 2 に記載の接続構造体。

【請求項 6】
前記異方性導電性接着フィルムは、半田粒子を含み、
前記半田粒子の最大長さの平均値が、1 μm 以下である、請求項 2 に記載の接続構造体。

50

【請求項 7】

前記異方性導電性接着フィルムは、半田粒子を含み、
前記半田粒子の最大長さが、 $5\text{ }\mu\text{m}$ 以下である、請求項 2 に記載の接続構造体。

【請求項 8】

前記異方性導電性接着フィルムは、半田粒子を含み、
前記半田粒子の最大長さが、 $3\text{ }\mu\text{m}$ 以下である、請求項 2 に記載の接続構造体。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

本発明〔1〕は、面方向に並ぶ複数の第 1 電極を有する第 1 基材と、前記面方向に並ぶ複数の第 2 電極を有し、前記第 1 電極および前記第 2 電極が対向するように、前記第 1 基材に対して、前記面方向に直交する厚み方向において間隔を隔てて配置される第 2 基材と、前記第 1 基材および前記第 2 基材の間に介在し、前記厚み方向において対向する前記第 1 電極および前記第 2 電極を、電氣的に接続するとともに、前記第 1 基材および前記第 2 基材を接着する接着層とを備え、前記接着層の厚みが、 $15\text{ }\mu\text{m}$ 未満であり、前記面方向において、隣り合う前記第 1 電極の間の距離が、前記厚み方向において対向する前記第 1 電極と前記第 2 電極との間の距離よりも長い、接続構造体である。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

本発明〔2〕は、前記接着層は、異方性導電性接着フィルムの硬化物であり、前記接着層は、前記厚み方向において対向する前記第 1 電極および前記第 2 電極を電氣的に接続する柱状半田部および硬化樹脂を含む、上記〔1〕に記載の接続構造体を含んでいる。

10

20

30

40

50